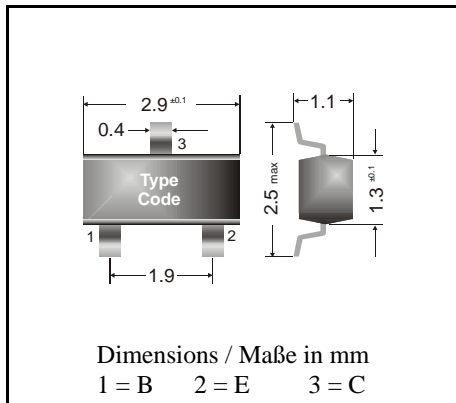


PNP

**Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage**

PNP

Version 2004-05-04



Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23  
Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

			MMBT2907	MMBT2907A
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	40 V	60 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	60 V	
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		$-I_C$	600 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	800 mA	
Junction temp. – Sperrschichttemperatur		$T_j$	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 65...+ 150°C	

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

			Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
$I_E = 0, -V_{CB} = 50\text{ V}$	MMBT2709	$-I_{CB0}$	–	–	20 nA
	MMBT2709A	$-I_{CB0}$	–	–	10 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 50\text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$		$-I_{CB0}$	–	–	20 $\mu\text{A}$
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. <sup>1)</sup>					
$-I_C = 150\text{ mA}, -I_B = 15\text{ mA}$		$-V_{CEsat}$	–	–	400 mV
	$-I_C = 500\text{ mA}, -I_B = 50\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	–	1.6 V
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>					
$-I_C = 150\text{ mA}, -I_B = 15\text{ mA}$		$-V_{BEsat}$	–	–	1.3 V
	$-I_C = 500\text{ mA}, -I_B = 50\text{ mA}$	$-V_{BEsat}$	–	–	2.6 V

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 0.1\text{ mA}$	MMBT2709	$h_{FE}$	35	–
	MMBT2709A	$h_{FE}$	75	–
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 1\text{ mA}$	MMBT2709	$h_{FE}$	50	–
	MMBT2709A	$h_{FE}$	100	–
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 10\text{ mA}$	MMBT2709	$h_{FE}$	75	–
	MMBT2709A	$h_{FE}$	100	–
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 500\text{ mA}$	MMBT2709	$h_{FE}$	30	–
	MMBT2709A	$h_{FE}$	50	–
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 150\text{ mA}$		$h_{FE}$	100	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 20\text{ V}$ , - $I_C = 50\text{ mA}$ , $f = 100\text{ MHz}$		$f_T$	200 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10\text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$		$C_{CB0}$	–	8 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
- $V_{EB} = 2\text{ V}$ , $I_C = i_c = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$		$C_{EB0}$	–	30 pF
Noise figure – Rauschzahl				
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ , - $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$ , $R_S = 1\text{ k}\Omega$ , $f = 10\text{ Hz} \dots 15.7\text{ kHz}$		F	–	4 dB
Switching times – Schaltzeiten				
turn-on time	- $V_{CC} = 30\text{ V}$ , - $V_{BE} = 1.5\text{ V}$ - $I_C = 150\text{ mA}$ , - $I_{B1} = 15\text{ mA}$	$t_{on}$	–	–
delay time		$t_d$	–	–
rise time		$t_r$	–	–
turn-off time	- $V_{CC} = 30\text{ V}$ , - $I_C = 150\text{ mA}$ - $I_{B1} = -I_{B2} = 15\text{ mA}$	$t_{off}$	–	–
storage time		$t_s$	–	–
fall time		$t_f$	–	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>	
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		MMBT2222, MMBT2222A		
Marking - Stempelung		MMBT2907A = 2F MMBT2907 = (M)2B		

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß